



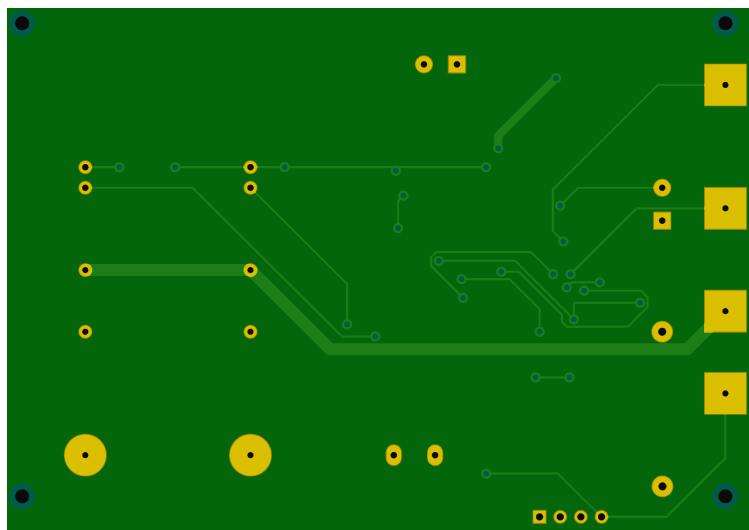
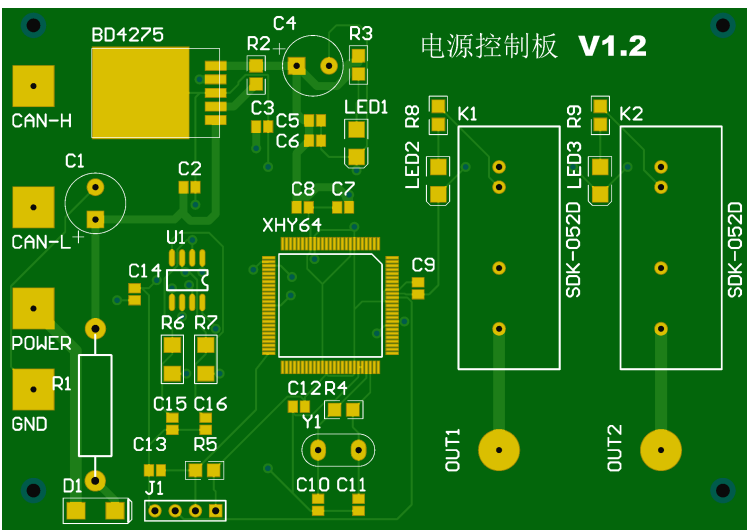
检查报告

时间2022-01-05


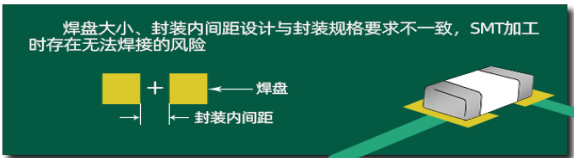
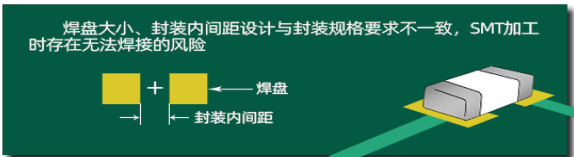
文件名：电源控制板

层数：2

尺寸：-2.00*-1.00 mm



警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
电气信号	锐角	1个	 <p>锐角会导致信号走向突变，造成信号反射、传输不连续。</p> <p>不推荐直角、锐角</p> <p>尽量采用圆角、钝角</p> <p>您的设计中布线存在“锐角”连接方式，会影响产品的信号完整性，建议将“锐角”位置调整为圆弧或钝角的连接方式</p>
焊盘规格	封装内间距异常	有异常	 <p>焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致，SMT加工时存在无法焊接的风险</p> <p>焊盘</p> <p>封装内间距</p> <p>您的设计与封装规格要求的大小不一致，请排查问题</p>
焊盘规格	焊盘大小异常	有异常	 <p>焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致，SMT加工时存在无法焊接的风险</p> <p>焊盘</p> <p>封装内间距</p> <p>您的设计与封装规格要求的大小不一致，请排查问题</p>

孔环	插件孔孔环	有	<div><p>孔环大小会影响孔环的附着力及线与孔壁链接的完整性，适当加大焊环可增强产品的可靠性。</p><p>过孔孔环 → ← 插件孔焊环 → ←</p><p>您的“插件孔焊环”最小为inf会影响生产效率、电气可靠性，建议“插件孔焊环”最小环 ≥ 8 mil</p></div>
----	-------	---	--

全部检查项

报告项目	类型	分析结果
电气信号	断头线	✔ 正常
	孤立铜	✔ 正常
	无效过孔	✔ 正常
	片式SMD没连线路	✔ 正常
	锐角	❗ 1pis 1个
最小线宽	最小线宽	✔ 正常
最小间距	线到线	✔ 正常 0.15237 mm
	盘到线	✔ 正常 0.15237 mm
	盘到盘	✔ 正常 0.15237 mm
最小焊盘	BGA焊盘	✔ 正常
	常规焊盘	✔ 正常
	长条焊盘	✔ 正常
SMD间距	同网络SMD焊盘间距	✔ 正常 0.249936 mm
	不同网络SMD焊盘间距	✔ 正常 0.249936 mm
	同器件焊盘间距	✔ 正常 0.249936 mm
	不同器件焊盘间距	✔ 正常
网格铺铜	网格线宽	✔ 正常
	网格线距	✔ 正常

孔大小	最小孔径	✔ 正常 0.7112 mm
	最大孔径	✔ 正常
	厚径比	✔ 正常
槽孔	最小槽宽	✔ 正常
	最大槽宽	✔ 正常
	槽长宽比	✔ 正常
孔环	过孔孔环	✔ 正常
	插件孔孔环	⚠ 8pis 有
孔到孔	同网络过孔	✔ 正常
	不同网络过孔	✔ 正常
	插件孔	✔ 正常
孔到线	过孔到表层	✔ 正常
	插件孔到表层	✔ 正常
	过孔到内层	✔ 正常
	插件孔到内层	✔ 正常
	NPTH到铜	✔ 正常
板边距离	铜/PAD/线到板边距离	✔ 正常
	SMD到板边距离	✔ 正常
	孔到板边	✔ 正常
特殊孔	半孔	✔ 正常
	盲埋孔	✔ 正常
	盲埋孔距离	✔ 正常
	激光孔	✔ 正常
	正/长方形孔	✔ 正常

焊盘规格	焊盘大小异常	⚠️ 3pis 有异常
	封装内间距异常	⚠️ 5pis 有异常
孔上焊盘	盘中孔	✅ 正常
	插件孔	✅ 正常
	过孔上焊盘	✅ 正常
	非金属孔	✅ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	✅ 正常
	阻焊盖线	✅ 正常
	阻焊间隙	✅ 正常
	同网络阻焊间隙	✅ 正常
	漏阻焊桥	✅ 正常
	同网络漏阻焊桥	✅ 正常
孔密度	孔密度	⚠️ 58个 ; 0.00万/m²
沉金面积	沉金面积	⚠️ 15.15%
飞针点数	飞针点数	⚠️ 218
Mark点	Mark点	✅ 正常
锣长分析	锣长分析	⚠️